

①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



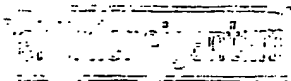
DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Off nl gungsschrift
⑪ DE 3027751 A1

⑤① Int. Cl. 3:
C25D 17/00

②① Aktenzeichen:
②② Anmeldetag:
④③ Offenlegungstag:

P 30 27 751.1
22. 7. 80
18. 2. 82



⑦① Anmelder:
Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

⑦② Erfinder:
Flögel, Lothar, Dipl.-Chem. Dr., 8021 Neuried, DE

⑤⑥ Recherchenergebnis gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG:

DE-AS	17 71 527
DE-AS	11 98 642
DE-GM	71 13 149
FR	6 60 276
US	30 39 951

⑤④ Vorrichtung zum galvanischen Metallisieren von Substraten

DE 3027751 A1

DE 3027751 A1

Patentansprüche.

- 1) Vorrichtung zum galvanischen Metallisieren von Substraten mit einem Halterahmen zum stabilen Halten der Substrate im Elektrolyten und Ankontaktieren an der Kontaktschiene (Kathode), d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß ein vorzugsweise u-förmiger Profilrahmen (1) aus beständigem, nichtleitendem Material zur Aufnahme von ein oder mehreren Substraten (5) vorgesehen ist, den oben die leitende Kontaktschiene (2) und parallel dazu ein nichtleitender Substratanschlag (5) überbrücken, daß ferner zwischen der Kontaktschiene und dem Substratanschlag Klauen (4) zum Ankontaktieren der Substrate befestigt sind, daß außerdem oben an der Kontaktschiene zum leitenden Befestigen des Rahmens verstellbare Halterungen (10) angebracht sind und daß die für die Aufnahme der Substrate dienende Innenseite des Profilrahmens an der Vorder- und Rückseite teilweise durch Blenden (16) abgedeckt ist.
- 20 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sich der Substratanschlag (3) leistenförmig (11) an den Seitenwänden und am Boden des Profilrahmens fortsetzt und am Boden des Profilrahmens in geringem Abstand von dem Substratanschlag Stifte (12) vorgesehen sind, die ein Wegrutschen der vorzugsweise Rücken an Rücken eingelegten Substrate verhindern.
- 30 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß in den Seitenteilen und im Boden des Profilrahmens durchgehende Bohrungen (13, 14) vorgesehen sind, deren Achsen in der Ebene der Substrate liegen, und daß der Rahmen mit einem breiten Abschirmrand (17) versehen ist.
- 35 4. Vorrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -

130067/0223

BAD ORIGINAL

k e n n z e i c h n e t , daß die Kontaktierklauen (4), die ein spitzes und ein stumpfes Ende aufweisen, auf ihrer Innenseite mit selbstklebender strukturierter Metallfolie (6), vorzugsweise Kupferfolie, überzogen und 5 elastisch an den Substraten befestigt sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, d a d ü r c h g e - k e n n z e i c h n e t , daß die durchbohrten Kontaktierklauen (4) mit einer federnden Unterlegschei- 10 be (8), z. B. aus Silikongummi, an Substrat (5) und Kontaktschiene (2) befestigt (7, 9) sind.

SIEMENS AKTIENGESellschaft
Berlin und München

Unser Zeichen
VPA 80 P 7 1 1 2 DE

5 Vorrichtung zum galvanischen Metallisieren von Substraten.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum galvanischen Metallisieren von Substraten mit einem Halterahmen zum stabilen Halten der Substrate im Elektrolyten und An-
10 kontaktieren an der Kontaktschiene (Kathode).

Es ist bekannt, zu galvanisierende Teile an die Kontaktschiene anzuklemmen, um sie durch einen Elektrolyten hindurchführen zu können. Dabei erhält man aber keine gleich-
15 mäßige Metallverteilung über die Oberfläche des zu galvanisierenden Teiles. Wird eine sehr gleichmäßige Metallverteilung gewünscht, dann müssen entsprechende Vorrichtungen angefertigt werden, um die Stromverteilung und besonders die Kanteneffekte zu beeinflussen. Als Kanten-
20 effekt bezeichnet man den stärkeren Metallaufbau auf Rändern und Strukturkanten des zu galvanisierenden Werkstückes.

Bei der galvanoplastischen Nickel-Abscheidung auf Glas-
25 substraten sind für einen bestimmten Anwendungszweck die Anforderungen an die galvanoplastische Nickelabscheidung in Bezug auf innere Spannung und Homogenität der Nickelschicht sehr hoch. Diesen Anforderungen entspricht z. B. ein Nickel-Sulfamat-Elektrolyt. Bei einer Schichtdicke
30 von ca. 100 μm wird eine völlig plane Nickelschicht verlangt, die während der Galvanisierzeit gut auf den Aufdampfschichten haftet. Die Oberflächenrauigkeit darf z. B. 4 μm nicht überschreiten. Bei einem derartigen Verfahren kommt es darauf an, eine geforderte Schicht-
35 dicke von 90 bis 110 μm über den gesamten Nutzen zu erreichen. Die geforderte Metallverteilung wurde mit den herkömmlichen Klemmvorrichtungen auf den Substraten nicht

Wed 1 Plr/18. Juli 1980

130067/0223

vollständig erreicht, so daß ein beachtlicher Prozentsatz der hergestellten Formteile verworfen werden mußte. Darüber hinaus mußte die Klemmvorrichtung nach zwei- bis dreimaliger Verwendung abgeätzt werden, da sich auf dem 5 Teil, das in das Bad eintauchte, Nickel abgeschieden hatte.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine eingangs definierte Vorrichtung zu schaffen, die eine möglichst 10 gleichmäßige Metallverteilung auf dem Substrat gewährleistet und eine leichte Handhabung durch angeleitetes Bedienungspersonal ermöglicht.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß 15 ein vorzugsweise u-förmiger Profilrahmen aus beständigem, nichtleitendem Material zur Aufnahme von ein oder mehreren Substraten vorgesehen ist, den oben die leitende Kontaktschiene und parallel dazu ein nichtleitender Substratan-schlag überbrücken, daß ferner zwischen der Kontaktschiene 20 und dem Substratanschlag Klauen zum Ankontaktieren der Substrate befestigt sind, daß außerdem oben an der Kontaktschiene zum leitenden Befestigen des Rahmens verstellbare Halterungen angebracht sind und daß die für die Aufnahme der Substrate dienende Innenseite des Profilrahmens 25 an der Vorder- und Rückseite teilweise durch Blenden abgedeckt ist. Auf diese Weise wird eine Steigerung der Ausbeute durch bessere Metallverteilung auf der Substratoberfläche von z. B. 75 bis 80 % auf 100 % erreicht. Darüber hinaus ist die Qualität und Ausbeute von der Badgeometrie 30 weitgehend unabhängig. Die Galvanisiervorrichtung nach der Erfindung ist leicht zu bestücken, robust und gut zu handhaben. Sie zeichnet sich ferner durch eine einfache Bauweise und lange Lebensdauer aus. Alle Arbeitsschritte können in der Vorrichtung vorgenommen werden. Da alle 35 Teile der Vorrichtung, die in den Elektrolyten eintauchen, aus gegenüber dem Elektrolyten beständigem, nichtleitendem Material bestehen, findet eine Wildabscheidung von

130067/0223

BAD ORIGINAL

Metall nicht statt. Die Vorrichtung kann daher nach dem Galvanisieren sofort wieder verwendet werden.

Der Substratanschlag setzt sich leistenförmig an den
5 Seitenwänden und am Boden des Profilrahmens fort. Am
Boden des Profilrahmens sind in geringem Abstand von dem
Substratanschlag Stifte vorgesehen, die ein Wegrutschen
der vorzugsweise Rücken an Rücken eingelegten Substrate
verhindern.

10 Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind in den Seiten-
teilen und im Boden des Profilrahmens durchgehende
Bohrungen vorgesehen, deren Achsen in der Ebene der
Substrate liegen. Ferner ist der Rahmen mit einem breiten
15 Abschirmrand versehen. Dadurch ist gewährleistet, daß der
Elektrolyt und Reinigungslösungen gut abfließen können
und beim Galvanisieren der Elektrolytaustausch nicht be-
hindert wird. Der breite Abschirmrand verhindert ferner
ein Eindringen von Stromlinien durch die Bohrungen oder
20 Löcher.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind die
Kontaktierklauen, die ein spitzes und ein stumpfes Ende
aufweisen, auf ihrer Innenseite mit selbstklebender,
25 strukturierter Metallfolie, vorzugsweise Kupferfolie,
überzogen und elastisch an den Substraten befestigt. Es
können somit nichtleitende Klauen Verwendung finden, die
nur auf der zum Kontaktieren wichtigen Oberfläche mit
Metallfolie beklebt sind. Das spitze Ende wird zum Kon-
30 taktieren der Substratoberfläche verwendet. Es läßt sich
nach dem Galvanisieren wieder gut abheben.

Um eine elastische Befestigung der Kontaktierklauen an
den bruchempfindlichen Substraten zu gewährleisten, werden
35 die Kontaktklauen mit einer Schraube mit Silikongummi-
unterlagscheibe an Substrat und Kontaktschiene befestigt.
Die elastische Silikongummischeibe verhindert, daß die

Substrate bei zu stark angezogener Schraube springen.

Die Erfindung wird anhand der Figuren erläutert. Es zeigen:

5

Figur 1 einen Abschnitt einer Kontaktschiene mit einer Kontaktierklaue, Anschlagschiene und Substrat,

10

Figur 2 die Kontaktierung in der Seitenansicht zwischen der Kontaktschiene, der Kontaktierklaue und zwei Substraten und

Figur 3 in perspektivischer Darstellung einen Profilrahmen nach der Erfindung.

15

Ein vorzugsweise u-förmiger Profilrahmen 1 ist oben mit der leitenden Kontaktschiene (Kathode) 2 und einem parallel dazu verlaufenden Substratanschlag 3 überbrückt. Wie aus den Figuren 1 und 2 zu ersehen ist, sind zwischen der Kontaktschiene 2 und dem Substratanschlag 3 Klauen 4 zum Ankontaktieren von Substraten 5 befestigt. Die Kontaktierklauen 4 sind nichtleitend und auf der zum Kontaktieren wichtigen Oberfläche mit einer Metallfolie 6 beklebt. Als elastische Zwischenlage zwischen Schraubenköpfen 7 und den Klauen dienen federnde Unterlegscheiben 8. Die Klauen 4 werden auf den Schrauben mit Muttern 9 festgehalten.

30 An der Kontaktschiene 2 ist eine höhenverstellbare Halterung 10 aus vorzugsweise rostträgem Stahl vorgesehen. Sie dient zum Befestigen an der Warenstange und als Stromleitschiene. Durch die Höhenverstellbarkeit kann so unterschiedlichen Abständen zwischen Kontaktschiene und Badniveau Rechnung getragen werden.

35

An den Seitenwänden und am Boden des Profilrahmens ist der Substratanschlag mit 11 bezeichnet. Stifte 12 ver-

- 5 - VPA 80 P 7 1 1 2 DE

hindern ein Wegrutschen der Substrate. In den Seitenwänden sind Löcher 13 und im Boden des Profilrahmens Löcher 14 vorgesehen. Damit wird eine ausreichende Badbewegung und ein guter Abfluß für Spülwasser gewährleistet.
5 leistet.

Vorder- und Rückseite des Rahmens enthalten Gewindebohrungen 15 zum Befestigen der Blenden 16. In der Figur 3 wurde die vordere Blende 16 weggelassen, um den
10 Einblick in den Profilrahmen nicht zu verdecken. Ein breiter Abschirmrand 17 verhindert das Eindringen von Stromlinien durch die Bohrungen bzw. Löcher.

Der Profilrahmen nach der Erfindung kann zur Aufnahme
15 eines oder mehrerer Substrate konstruiert sein. Beim gleichzeitigen Galvanisieren von geradzahligen Substraten, z. B. vier, werden jeweils zwei mal zwei Substrate Rücken an Rücken in den Profilrahmen eingesetzt.

20 Der Profilrahmen nach der Erfindung kann auch von angelerntem und unerfahrenem Personal leicht gehandhabt werden. Nach dem Bestücken des Profilrahmens mit z. B. vier Substraten erfolgt das Einhängen des Rahmens in den Elektrolyten. Nach der galvanoplastischen Abscheidung
25 des Metalls sind die Substrate nach dem Lösen der Kontaktierklauen leicht aus dem Profilrahmen zu entnehmen. Ohne Zwischenbehandlung steht der Profilrahmen sofort für einen neuen Arbeitsgang zur Verfügung.

5 Patentansprüche

3 Figuren

3027751

- 9 -

1/2

Nummer:

Int. Cl.³:

Anmeldetag:

Offenlegungstag:

3027751

C25D 17/00

22. Juli 1980

18. Februar 1982

80 P 7 1 1 2 DE

FIG 1

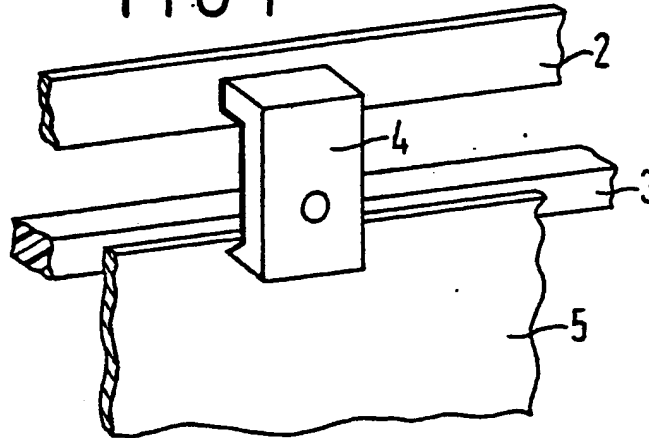
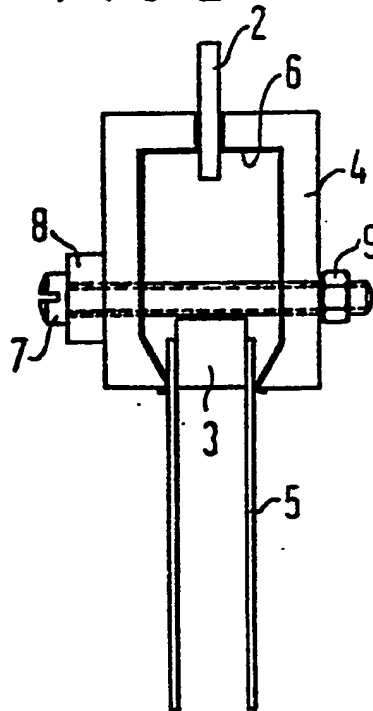


FIG 2



130067/0223

DERWENT-ACC-NO: 1982-13910E

DERWENT-WEEK: 198208

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Electrodeposition esp. of nickel
onto glass - using cathode bar connected by claw
contacts to suspended glass
plates

INVENTOR: FLOEGEL, L

PATENT-ASSIGNEE: SIEMENS AG[SIEI]

PRIORITY-DATA: 1980DE-3027751 (July 22, 1980)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PAGES	PUB-DATE	
LANGUAGE		MAIN-IPC	
DE 3027751 A		February 18, 1982	N/A
010	N/A		
DE 3027751 C		July 6, 1989	N/A
000	N/A		

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
DE 3027751A	N/A	
1980DE-3027751	July 22, 1980	

INT-CL (IPC): C25D017/00

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3027751A

BASIC-ABSTRACT:

Electrodeposition appts. for metallising substrates
comprises a U-shaped frame
(1) of non-conducting material intended to be immersed in
the electrolyte bath
and an electrical supply conductor bar (2) across the
opening of the U;
Parallel to this conducting bar and below it is a

non-conducting spacer bar
(3). The substrates to be coated are hung vertically
alongside this spacer
bar, clamp-d to it by contact claws gripping across the bar
(3) and across the
current supply bar (2). The feed into the conducting bar
(2) is through
suspension hooks (10) which can be adjusted in height and
serve also for
suspending the entire frame in the bath. The inner face of
the U-frame (1) is
partly blanked off at front and back by plates (16).

Used esp. for the deposition of nickel on glass sheets.
The appts. enables a
very good and uniform electrical contact between the glass
sheet substrates and
the cathode contact bar (2) to be obtd. This results in a
very uniform coating
thickness, meeting the requirements of 100 microns +/- 4
micron over the entire
area.

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3027751C

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

Electrodeposition appts. for metallising substrates
comprises a U-shaped frame
(1) of non-conducting material intended to be immersed in
the electrolyte bath
and an electrical supply conductor bar (2) across the
opening of the U;
Parallel to this conducting bar and below it is a
non-conducting spacer bar
(3). The substrates to be coated are hung vertically
alongside this spacer
bar, clamp-d to it by contact claws gripping across the bar
(3) and across the
current supply bar (2). The feed into the conducting bar
(2) is through
suspension hooks (10) which can be adjusted in height and
serve also for
suspending the entire frame in the bath. The inner face of
the U-frame (1) is
partly blanked off at front and back by plates (16).

Used esp. for the deposition of nickel on glass sheets.